

Presseinformation

19.03.2014

Henkel auf der SMT Hybrid Packaging 2014

Hochtechnologieklebstoffe für die Mikroelektronik

Im Geschäftsfeld Elektronik bietet Henkel Kunden aus der Elektronikindustrie weltweit ein spezialisiertes Portfolio von innovativen Hochtechnologieklebstoffen für die Fertigung von Mikrochips und Elektronikbaugruppen an. Dazu gehören Schmelzklebstoffe für empfindliche elektronische Komponenten wie auch Lötpasten für die Montage von Leiterplatten, die im Mittelpunkt des Messeauftritts von Henkel auf der SMT Hybrid Packaging vom 6. bis 8. Mai 2014 in Nürnberg stehen.

Unter der Marke Technomelt bietet Henkel innovative Schmelzklebstoffe, die im Niederdruck-Spritzgussverfahren eingesetzt werden können. Damit ist es möglich, nicht nur Oberflächen miteinander zu verkleben, sondern auch kleine und empfindliche elektronische Komponenten schonend zu ummanteln. Insbesondere in der Automobilindustrie sowie in der Medizintechnik spielt die Beständigkeit der eingesetzten Klebstoffe gegenüber Umwelteinflüssen wie unterschiedlichen Temperaturen, Feuchtigkeit und Lösemitteln oder Ölen eine entscheidende Rolle, um die Leistungsfähigkeit von Sensoren und anderen empfindlichen Bauteilen zu gewährleisten.

Im Niederdruck-Spritzgussverfahren werden die Bauteile ohne ein Gehäuse in eine Form gelegt und direkt mit dem Schmelzklebstoff umhüllt. Nachdem die Masse abgekühlt ist, können die – jetzt mit einer festen Umhüllung versehenen – Komponenten weiterverarbeitet werden. Durch das Einkomponentensystem des Verfahrens entsteht ein einfacher, sehr schneller und sauberer Produktionsprozess. Dank des niedrigen Verarbeitungsdrucks wird eine sanfte Verarbeitung sichergestellt. Es ist dadurch möglich, auch kleine und empfindliche Bauteile mit einem Schmelzklebstoff zu ummanteln. Gerade für Leiterplatten und elektronische Bauteile eignet sich dieses Verfahren daher besonders gut. Weil mit dieser Methode fast jede

Gehäuseform und Ummantelung möglich ist, lässt sie sich leicht für viele Produktgeometrien einsetzen. Henkel bietet unter Technomelt eine breite Produktpalette an Schmelzklebstoffen auf Polyamid- und Polyolefin-Basis, die je nach spezifischer Anforderung nicht nur unterschiedliche Vorteile mit Blick auf Temperaturresistenz, Haftung auf verschiedenen Materialien und Härte bieten, sondern auch in unterschiedlichen Farben erhältlich sind.

Hochleistungsfähige halogenfreie Lötpaste

Sein Portfolio an halogenfreien Produkten hat Henkel mit Loctite Multicore HF 212 weiter ausgebaut: Die halogen- und bleifreie Lötpaste ist ideal geeignet für die Montage moderner hochwertiger Leiterplatten. Wie die anderen halogenfreien Formulierungen der Produktreihe wird Loctite Multicore HF 212 ohne Zusatz von Halogen hergestellt; der Chlor- und Bromgehalt liegt in strengen Tests unterhalb der Nachweisgrenze. Dank seiner gleichmäßigen Druckleistung und optimalen Formstabilität, selbst in Klimaregionen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent bietet Loctite Multicore HF 212 eine ausgezeichnete Stabilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Umweltbedingungen. Das Material zeigt eine extrem geringe Neigung zur Void-Bildung bei CSP mit Via-in-Pad-Verbindungen, gute Koaleszenz und ausgezeichnete Lötbarkeit auf vielen verschiedenen Oberflächen wie Ni/Au, Immersion Sn, CuNiZn, Immersion Ag und OSP Kupfer.

Bei Elektronikbauteil-Herstellern weltweit ermöglicht Loctite Multicore HF 212 robustere Druckprozesse. Einer der größten Vorteile für den Betrieb ist die außerordentlich lange Schablonenlebensdauer der Paste. In einem Umfeld, in dem Kostenkontrolle von entscheidender Bedeutung ist, stellt die Möglichkeit, die Paste über sehr lange Zeiträume – sogar bis zum Beginn der nächsten Schicht – ohne Qualitätsverlust auf der Schablone zu belassen, einen enormen Vorteil dar. Es muss auf diese Weise wesentlich weniger Lötpaste entsorgt werden als mit herkömmlichen Produkten, was für eine deutliche Kostensenkung sorgt.

Während der SMT Hybrid Packaging vom 6. bis 8. Mai 2014 informieren Henkel-Experten in Halle 9, Stand 353, über das vielfältige Portfolio des Unternehmens für die Elektronikbranche.

Weitere Informationen unter www.henkel.com/electronics.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr

2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt	Lisa Kretzberg	Holger Elfes
Telefon	+49 211 797-56 72	+49 211 797-99 33
E-Mail	lisa.kretzberg@henkel.com	holger.elfes@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Mit den Technomelt Schmelzklebstoffen ist es möglich, nicht nur Oberflächen miteinander zu verkleben, sondern auch kleine und empfindliche elektronische Komponenten schonend zu ummanteln.



Die halogen- und bleifreie Lötpaste Loctite Multicore HF 212 ist ideal geeignet für die Montage moderner hochwertiger Leiterplatten.

